(9) 日本国特許庁 (JP)

⑫公開特許公報(A)

⑩特許出顧公開 昭58—180927

⑤Int. Cl.³ G 01 L 9/04 // H 01 L 29/84 識別記号 101 庁内整理番号 7507-2F 7357-5F ❸公開 昭和58年(1983)10月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

の半導体感圧素子の保護装置

2)特

願 昭57-62492

②出

顧 昭57(1982) 4月16日

⑫発 明 者 石井明

東京都府中市東芝町 1 東京芝浦 電気株式会社府中工場内

の出願 人東

人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

朗 網 #

1. 発明の名称

半導体感圧業子の保護装置

2.特許請求の範囲

- (1) 圧力を電気信号に変換する感圧素子の超通 部との間にその超通部が変位するための空間 を形成する基台機に、超通部との対向面が舞 曲して形成され、超通部がその弾性限界を越 えて変位する以前にその起亜部と密着し、起 通部のそれ以上の変位を阻止する変位阻止体 を配置したととを特徴とする単導体感圧業子 の保護装置。
- (2) 変位阻止体が基台と一体成形されたことを 特許請求の範囲第1項記載の半導体感圧素子 の保護装置。
- (3) 感圧案子が肉薄の起亜部と肉厚の周辺部とからなる凹形に形成され。変位阻止体がこの凹所内に配置されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体感圧素子の保護装置。

- (4) 家位阻止体が、底圧素子と基合とを接合する膜の極度より高い融点を持つ材料で構成されたことを停散とする特許請求の範囲第3項記載の半導体底圧素子の保護模様。
- (5) 変位業止体が、加熱硬化剤で構成されたと とを特徴とする特許請求の範囲第 3 項記載の 半導体線圧象子の保護機能。

3. 福養の詳細な説明

(発明の技能分野)

本種別は、圧力に応じて変位しその圧力を 電気信号に変換する半導体感圧素子の保護装 置に関する。

(発明の技術的背景)

使来、半導体底圧集子により圧力を検出する機能としては、第1回に示すような差圧変換器10が知られている。との差圧変換器10は、ピエン抵抗素子を拡散した半導体感圧素子11と、この底圧素子11の対向固にそれぞれ異なる圧力を印加するための洗過路124、12bを形成する本体ケース13と、この

本体ケース 1 3 の 各流通路 12 a, 12b 内に圧力 伝達媒体 14 a, 14b を夫々封入する受圧ダイア フラム 15 a, 15b と, この受圧ダイアフラム 15 a, 15b の外面に被測足圧力 Pa, Pb を導く受 圧フランジ 16 a, 16b とから構成されている。

この被測定圧力 P_a , P_b は、各受圧ダイファラム 15a, 15b 、圧力伝達媒体 14a, 14b を介して感圧素子 11 の各面に印加される。そして、その差圧(P_a — P_b)に応じて感圧素子 11 が 協み体気信号として検出される。

ところで、半導体感圧素子11 は、差圧に 応じて続むととによりそのピエゾ抵抗素子の 抵抗値変化として圧力を捕えるものであるが、 その弾性限界を魅えた被測定圧力が印加され ると破損してしまりため、本体ケース13 内 に当圧防止機構が設けられている。

との過圧防止機構は、前紀圧力伝達媒体 14a、14b にその内外面が接液され何媒体 14a、 14b を区画するペローズ 17 、 とのペローズ 17 に取着された弁練 18 の 両端に設け 5 れそれぞれ被測定媒体 14a, 14b 内に配置された弁体 18a, 18b 及びこの弁体 18a, 18b のベローズ 1 7 側に取着され、前配本体ケース 1 3 の実起部 13a, 13b に対向配置されたオーリング 19a, 19b とから構成されている。

この過圧防止機構は、次のようにして感圧 素子 1 1 に過大圧が印加されるのを防止して いる。例えば今、被難定圧力 Pb が過大圧と なると、受圧ダイアフラム 15b 及び圧力伝達 維体 14b を介してベローズ 1 7 及び弁体 18a, 18b が図中左方向に移動する。そして、これ に伴い弁体 18b 何のオーリング 19b が前配突 超都 13b に告着し、前配被測定媒体 Pb を 伝 達する 圧力伝達媒体 14b の移動を阻止する。 この媒体 14b の移動が阻止されることにより、 過大圧 Pb が縁圧素子 1 1 へ伝達されることは なくなる。

したがつて、との過圧防止機構が底圧素子 11 の弾性観界を越えない圧力で機能するように構成するととにより底圧素子 11 を 過大

圧から保護するととができる。

〔背景技術の問題点〕

しかしながら、このような過圧防止機構を本体ケース 13 内に設けることにより、構造が大形化し、温度変化の影響を受ける圧力伝達媒体 14a, 14b の量が増大する結果となり、好ましいとは言えない。また、圧力伝達媒体の移動を阻止するという間接的な過圧防止手段でもり、好ましくは直接的な手段が信頼性、安全性等の固から要望されている。

(毎明の目的)

本発明は、上配要選に対処して成されたもので、 核正案子の起張部の変位を直接阻止で きる半導体感圧案子の保護機能を提供するも のである。

(発明の概算)

本発明は、感圧業子の超強部に対面する薄曲面を有する変位阻止体を、感圧案子を保持する基台と超強部との間に設けられた空間部内に配置して構成し、起強部が過大圧により

要位する以前にこの変位阻止体と密着して起 盃部のそれ以上の変位を阻止するものである。 〔程明の実施例〕

以下、本発明の一実施例につき第2図を参う 無して説明する。

20 は環状に形成された半導体感圧素子である。この感圧素子20 は、中心部に形成された内容を超重部21 とその外間に形成された内障の脚部22 とから構成され、その回側に凹所を有している。また、超重部21 の他回側には、超重部21 の他回側には、超重部21 の低回側には、超重なが例とは、変化するをが、で、変化するとのが、変化されている。

30 は、平板状に形成され、中心に導圧口31を有する基台である。この基台30 には、 前配感圧常子20 の脚路22 が装着剤32 等 により固着されている。すまわち、この両者 20、30 は、前配超亜部21 の一面側に空間 部32を残し一体に形成される。

40 は との空間部 32 内 に配置された変位 阻止体である。この変位阻止体 40 は、前配 基台 30 の 導圧口 31 に 連通する導圧口 41 を有している。また、この変位阻止体 40 は、 前配空間部 32 の 内径とほぼ同一の外径を有 し、最大高さが前配蓋台 30 上面から配歪部 21 一面までの距離とほぼ同一に選択されている。

そして、との変位阻止体 40 の 前配起歪邸 21 と対向する面は、 寿曲 に形成されている。 との 寿曲 面 42 は、 前記超歪部 21 が その 弾性 限界を超えて変位する以前の形状に合致し、 かつその 際起歪部 21 に 密着する位置に配置されている。

また。との変位阻止体 40 は、単化基台 30 上に戦闘しておいても良いが、接着刑等により基台 30 上に固着した方が安全上好ましい。

さて、このように感圧素子20 と善台30

と基台 3.0 とを別体に構成して説明したが、 第 4 図に示す如く両者を一体に構成しても良い。 育曲面の形成は、超音波加工技術等により行なう。 との実施例によれば、一実施例の 如く両者 3.0、4.0 を接着刑等で固定する手間 が省ける利点がある。

また、一実施例では、凹所を有する感圧素子 20 を用いて説明したが、第 5 図に示すよりに感圧素子 20 が平板状の場合にも本発明を適用することができる。すなわち、この場合感圧素子 20′の超亜部 21′と対面する部分を博曲面 42′とした基台 30′を用いれば、約配一実施例同様の効果を実することができる。もちろん、基台 30 に凹部を形成し、この凹部内に前配変位阻止体 40 を配置するように形成しても良い。

また、変位因止体 40 の 材質としては、復 々考えられるが加工容易性を優先した場合に は、例えば軟鋼、黄鋼あるいはアルミニウム 等の金質材料が適している。また、感圧象子 との間に変位阻止体 4 0 を配置した状態で、 個中上方から圧力が印加されるも、感圧素子 2 0 の超速部 2 1 は その印加圧力に応じて図 中下方向に変位する。そして、この変位量に 応じて射記紙状層 2 3 の抵抗値が変化する。 すなわち、印加圧力は、機械的変位量に変換 された機能気信号として射記電器 2 4 及びリ ード値 2 5 を介して外部へ取出される。

とのようにして印加圧力は検出されるが、 との印加圧力が、前記起張部21 にその弾性 限界を越える変位を生じさせる過大圧となつ を場合には、従来の過圧防止機構と異なり、 本発明ではその変位そのものを直接阻止する。

すなわち、無多関に示すように超速部 2 1 は、図中下方向に変位するが、変位阻止体 4 0 に 当接しそれ以上の変位は強制的に阻止 される。したがつて、いくら印加圧力が過大 圧となつても、起道部 2 1 がその弾性膜外を 離えて変位することはなくなる。

なか、との一笑施例では、変位阻止体 40

20 と基台30 とは例えば菩蘭ガラス等で袋 港するため、安位阻止体40 の材料には、袋 着時の傷度よりも薔蘭点の高い材料を選択する必要がある。

また。安位国止体 40 を 前述のように予め 加工して空間都32円に配置して説明したが、 次のようにして変位因止体 40 を 構成しても 良い。すなわち、扇圧集子20 と当台80 と を養着固定した後。との基台 80 の 導圧口 31 から被状のエポキシ系接着剤を住入し加 熱硬化させる。そして、硬化的に、底圧素子 20 の起番部 21 に 過大圧を印加して変位さ せ、この状態のままで的紀エポキシ系装着剤 を加熱変化させる。変化後、超流部21を復 婚させることにより养歯面を持つ変位組止体 を形成させるととができる。なか、との場合。 材料としては、加熱硬化製度が、原圧素子 20 と基台 30 とを開着する装着剤の溶剤量・ 度より低いものを選択する必要がある。すな わち、材料の硬化温度がその装着剤の溶酸温

特開昭58-180927(4)

庭より高いと, 材料の硬化時化接着剤が溶験 してしまうために。それより低い硬化温度の ものを選択する。一般に、息圧象子20 と基 台3.0 との接着用に用いる接着剤として用い られる 低酸点ガラスあるいは共晶合金の部 融温度は 300℃~ 500℃と高いのに対し、エポ キシ系接着剤は 100℃で硬化するので低融点 ガラス等が溶散することはない。また。前記 起亜部 21 の 基台 30 質面には、 4 フッ化ェ テレン樹脂などの離型剤を塗布し、起歪部 21 とエポキン系接着刺とが接着しないよう にする。また、その中心に導圧口を形成させ るために、接着剤注入袋4フツ化エテレン樹 脂等のパイプを基台30の 導圧口31 から挿 入し硬化後収除くようにする。とのように実 際に起棄部21を変位させた状態で変位阻止 体を構成するととにより、所定印加圧力時、 すなわち起盗部 21 の 所定変位量で強実にそ の安位を阻止できる信頼性の高い安位阻止体 を実現できる。

第2 に、被測定圧力を伝達する圧力伝達鉄体の封入量を大幅に少なくできる。

第3 に、温度変化の影響を受ける伝達媒体 の量を少なくできることにより、温度依存性 の少ない測定結果を得ることができる。

第4 に。従来の過圧防止機構で問題となつ ていた応答性の問題もなく。また。オーリン グの圧縮による過大圧印加等の問題もなくな る。

さらに。従来の過圧防止機構にかいて必要 とされた各部の材質選択あるいは破構整等の 煩しさもなくなる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は従来の整圧伝送器を説明するための 断面図、第2回及び第3回は本語明の保護模量 を説明するためのもので、第2回は断面図、第 3回は作動状態を示す断面図、第4回及び第5 図はそれぞれ異なる他の実施例を示す断面図で ある。 また、変位阻止体 4 0 と起至部 2 1 と が接触する験、電気的絶縁を保持させたい場合には、起至部 2 1 の接触面に 8 i Os を成形 させれば良い。 5 5 5 ん、変位阻止体 4 0 何の接触面にも 8 i Os 被してもよい。 変位阻止体 4 0 が 節台 3 0 に一体に形成されている場合には、 8 i Os 被験、 金属の場合は 4 フッ化エチレン複勝等の被験を施せば良い。

(毎明の効果)

本発明は、 とのように 感圧素子の 起亜部に 接触し直接その変位を阻止するように 構成し たので、 確実に過大圧印加時の 起亜部の変位 を阻止することができる。

また、半導体感圧素子を組み込んだ圧力伝送器あるいは蓋圧伝送器において、従来設けられていた通圧防止機構を本発明の保護装置に代えることにより次のような効果がある。

まず、第1化多くのスペースを占めていた 使来の過圧防止機構を致くととができるので、 小頭領量化が計れる。

20……展压崇子

21 ……超五醇 ...

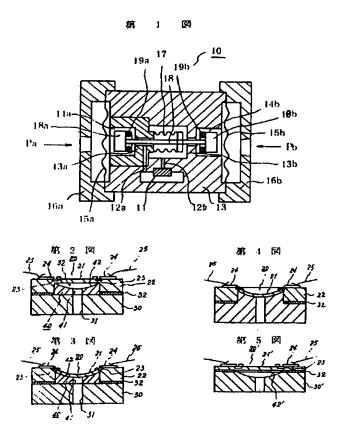
30 …… 当 台

40……安位阻止体

4 2 灣. 在面

代理人 弁理士 胤 近 憲 佑(ほか1名)

持開昭53-180927(5)



特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 57 年特許願第 62492 号 (特開 昭 58-180927 号, 昭和 58 年 10 月 22 日発行 公開特許公報 58-1810 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 6 (1)

Int.C1.	識別記号	庁内整理番号
G01L 9/04 // H01L 29/84	101	7 5 0 7 - 2 F 6 8 1 9 - 5 F

手 統 補 正 套(自発)

61.3.24 昭和 年 月 日

符件庁長官 殿

1. 年件の表示 特職昭 57-62492号

2. 発明の名称

半導体感圧素子の保護装置

3. 補正をする者

序件との関係 特許出額人 (307) 株式会社 東芝

4.代 璟 人

〒 105

東京都務区芝浦一丁目1 雷1 号 徐式会社東芝 本社事務所内

(7317) 弁理士 則 近 寮 佑。

5.補正の対象

明細帯の特許請求の範囲の側。

6. 棚正の内容

別紙のとおり。



特許請求の範囲

- (1) <u>底圧素子の超</u>預部の変位を可能にする基台 の超<u>西部との対向面を</u>,起亞部がその単性限 界を越えて変位する以前にその起亚部が密着 するように海曲面に形成したことを特徴とす る半導体感圧素子の保護袋機。
- (2) との超強部に対向する博曲所が基合上に取 着された変位阻止体面に形成されたことを特 数とする特許朋求の範囲第1項記載の半導体 感圧素子の保護装費。
- (3) <u>修圧零子の超</u>표形が内容に形成され、この 内容部内に変位阻止体が配置されたことを特 徹とする特許請求の範囲第2項記載の半導体 <u>終</u>圧累子の保護契備。